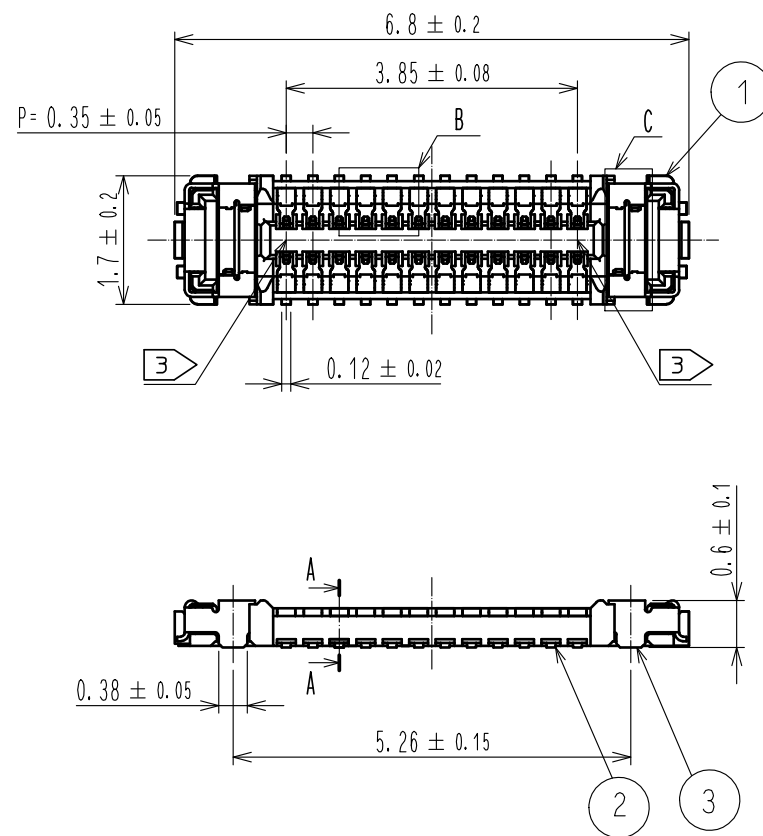


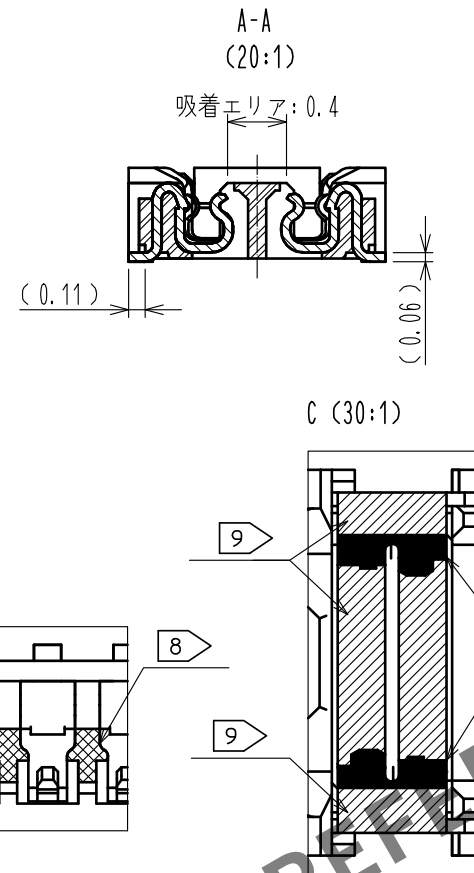


注 1 . 平坦度は0.08mm以内です。

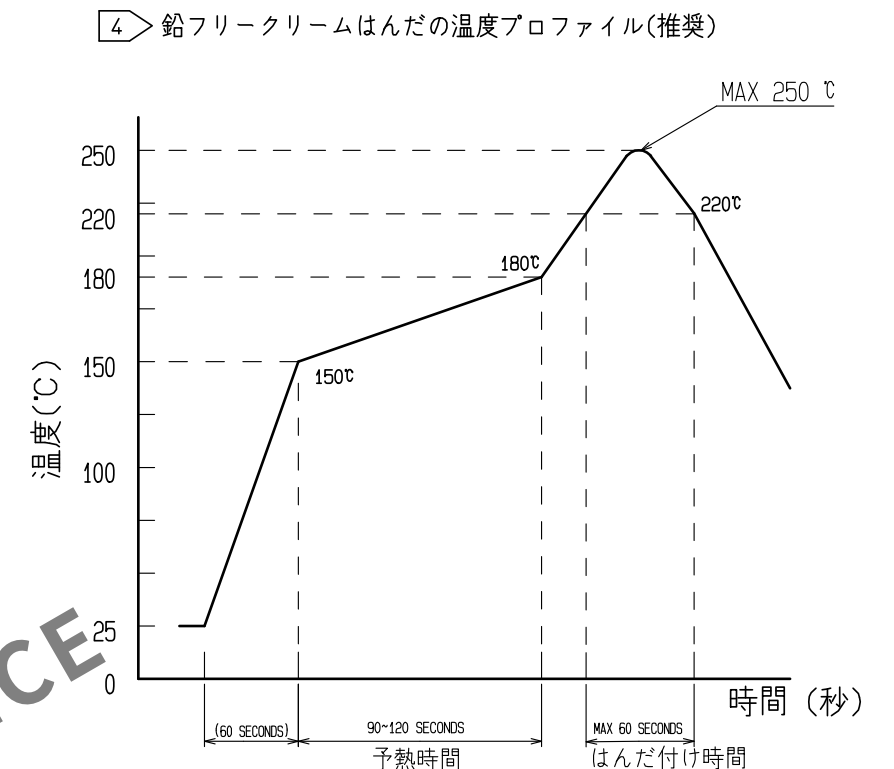
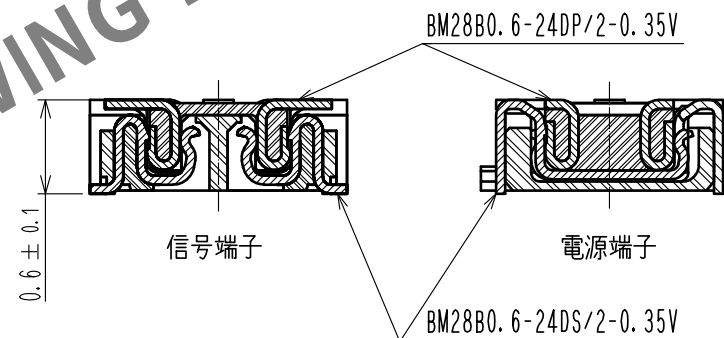
2 めっき仕様

接触部 : 金めっき0.05 μ m以上
リード部 : 金めっき0.05 μ m以上
下地 : ニッケルめっき1 μ m以上
(表面 : 封孔処理)

3 図示近辺にHRSマーク又はCAV No.を表示します。



嵌合断面图 (20:1)



リフロー方式：IRリフロー
リフローは2回以下とします。

1) リフロー部

220℃以上 60秒以下

(ピーク温度250℃)

2) プリヒート部

150~180℃ 90秒~120秒

4 この温度プロファイルは上記適用条件のものであります。

追加要因: クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、
その他実装部材等の条件により異なる場合がありますので、
実装状態を十分ご確認の上ご使用願います。
温度は端子リード部にて測定しています。

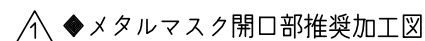
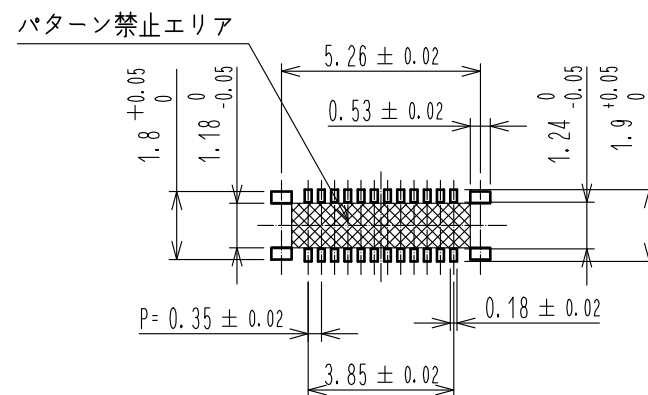
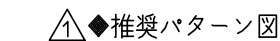
5. 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。

6. この製品は、最大900ppmの塩素、最大900ppmの臭素、および最大1500ppmの塩素と臭素の合計として定義されているハロゲンフリー要件を満たしています。

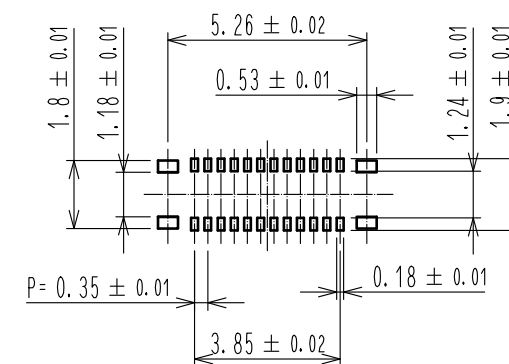
7. この製品はRoHSに準拠しています。

8 指定エリアにウェルドラインが現れる場合がありますが、性能への影響はございません。

9 このエリアに金メッキが付く場合があります。



メタルマスク厚さ : 80 μm



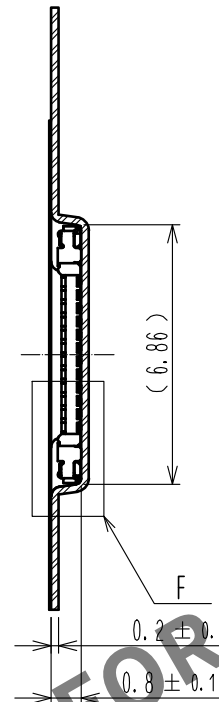
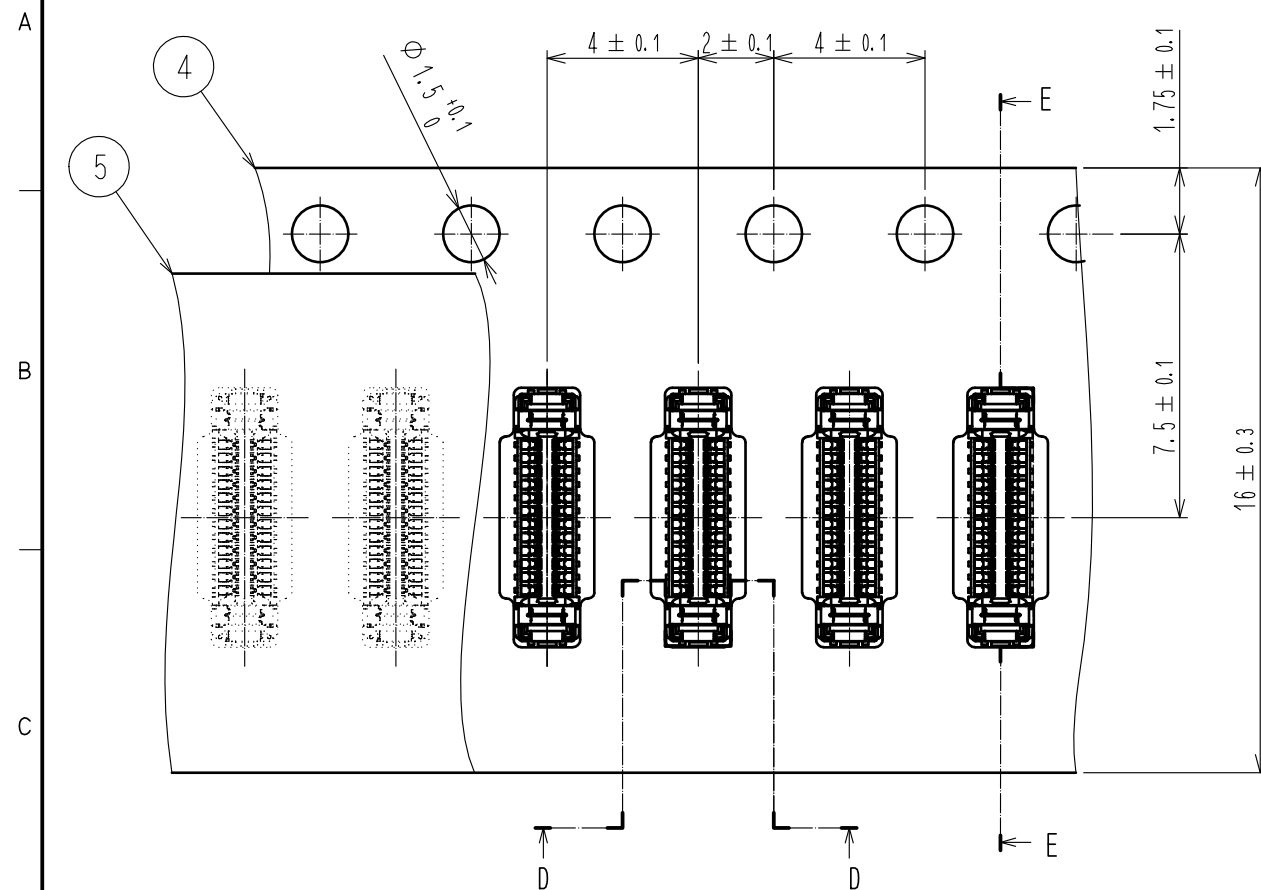
4	PS	CLEAR(エンボスキャリアテープ)				
3	銅合金	2		7	PS	CLEAR(補強用カラー)
2	銅合金	2		6	PS	BLACK(プラスチックリール)
1	LCP	UL94 V-0. BLACK		5	ポリエステル	CLEAR(カバーテープ)
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS

UNITS mm		SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
				3	DIS-H-00010401	KH. ODA	TS. MIYAZAKI	20210830
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				APPROVED	・WR. FUKUCHI	20200121	ADC-364666-51-00 DRAWING NO.	
				CHECKED	・TS. MIYAZAKI	20200121		
				DESIGNED	・KT. KUSAKA	20200121	CODE NO. CL0673-5025-0-51	
				DRAWN	・MN. SATOH	20200120		

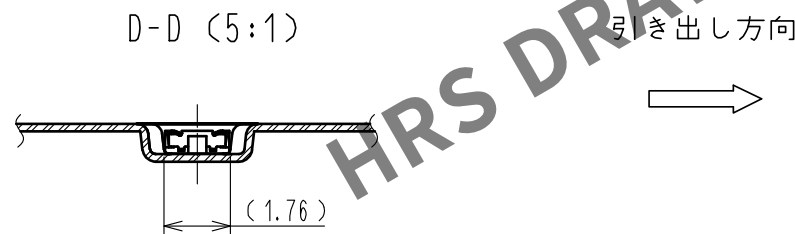
エンボスキャリアテープ (5:1)

E-E(5:1)

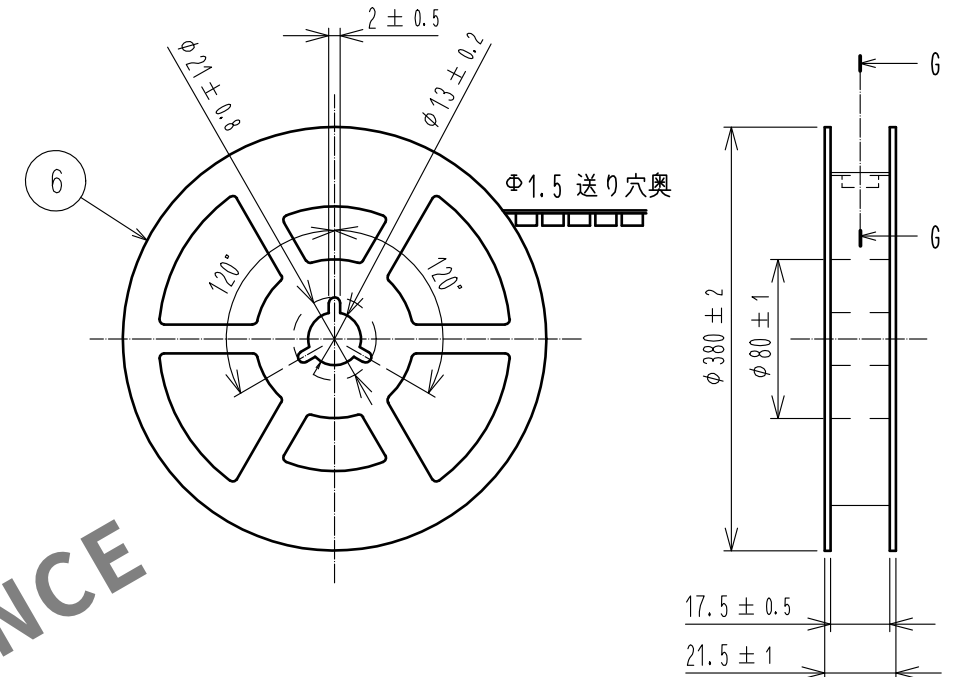
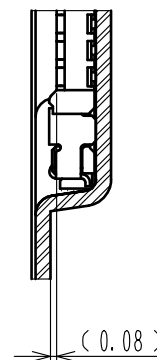
リール形状および寸法 (Free)



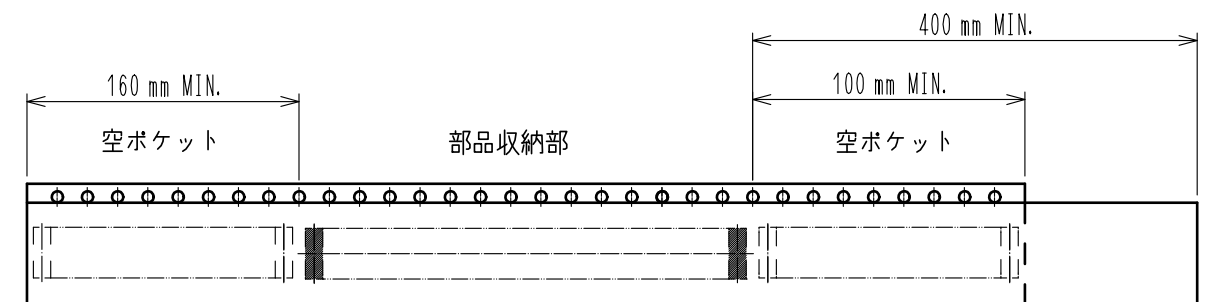
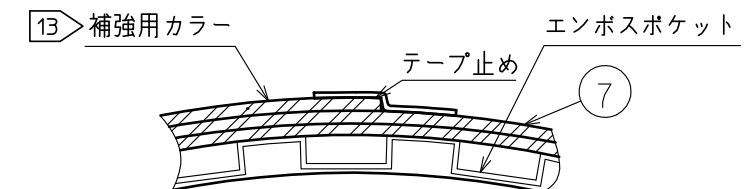
D-D (5:1)



F (10:1)



G-G (Free)



12 テーピング (Free)

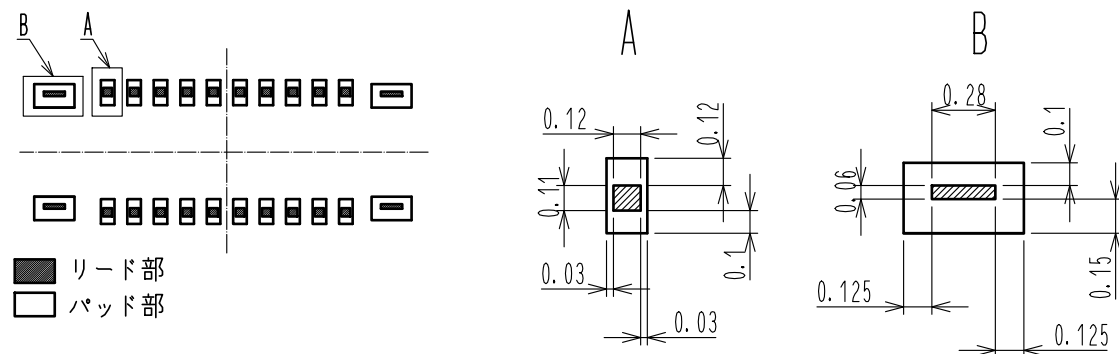
10. 1リール20,000個巻きです。
11. () 内寸法は参考寸法です。
12. エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC 60286-3) に準拠しております。
13. 梱包終了後、エンボスポケット外周に長さ2mの補強用カラーを巻き
外周終端部はテープ止めします。

HRS

DRAWING NO.	ADC-364666-51-00
PART NO.	BM28B0.6-24DS/2-0.35V<51>
CODE NO.	CL0673-5025-0-51

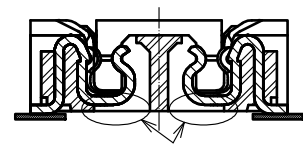
△14. 各注意点の詳細については、本シリーズガイドライン：ATAD-H1016をご参照ください。

基板パターンとコネクタの位置関係について



実装の注意点について

本製品は、コネクタ実装面側に端子露出部があります。
半田が実装面側から這い上がらないよう、基板パターン、メタルマスクは弊社推奨の寸法でご使用をお願いします。



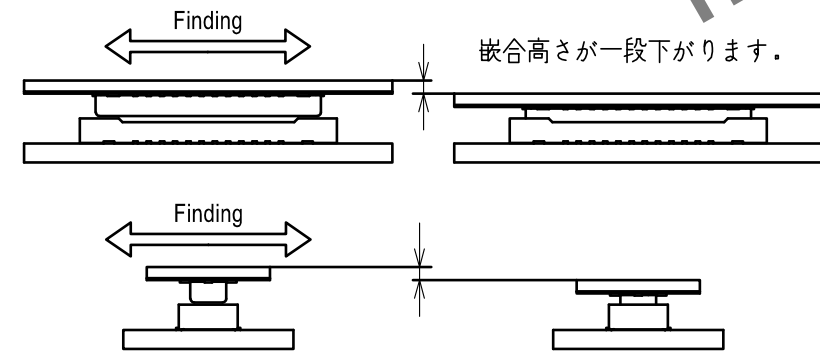
コネクタの嵌合方法に関して

本製品を嵌合させる際は、手で嵌合頂くようお願い致します。

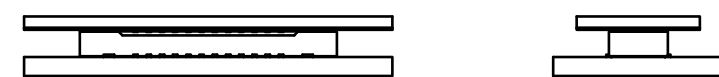
嵌合の手順

- (1) 誘い込みを手探りで探して、位置合わせを行って下さい。
本製品は嵌合をうまく誘い込む為、誘い込みのガイドリブを設けています。
位置合わせが出来ると、コネクタが誘い込まれます。
誘い込まれると、コネクタの嵌合高さが一段下がるのが、手感触でわかります。

コネクタを前後左右に動かし誘い込み口を探してください。



- (2) 誘い込まれた状態では、コネクタ同士が平行になっており、前後左右にコネクタを動かすことができない状態になっています。この状態から、嵌合を最後まで行って下さい。

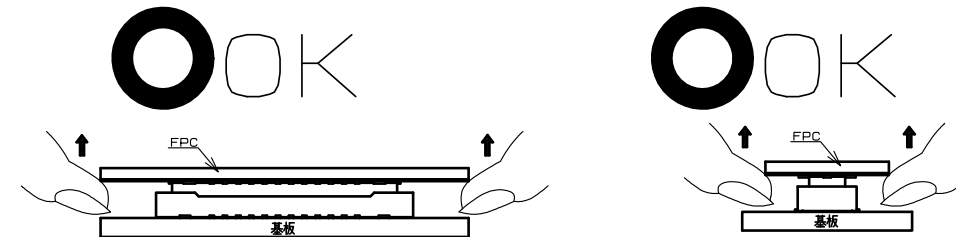


- (3) 嵌合が最後まで行われているか確認をしてください。
片側が浮いている場合や斜めに嵌合されている場合は、一度嵌合を外し、再度嵌合し直して下さい。

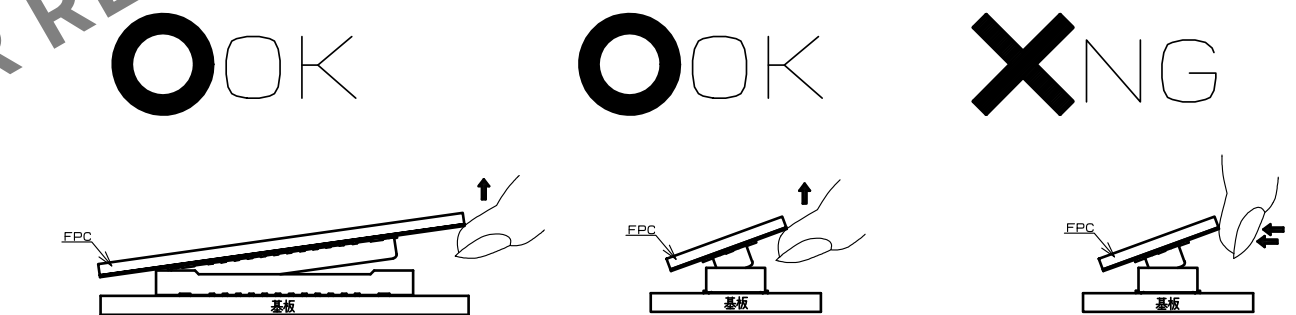
コネクタの取り外し方法に関して

本製品を嵌合させる際は、手で嵌合頂くようお願い致します。

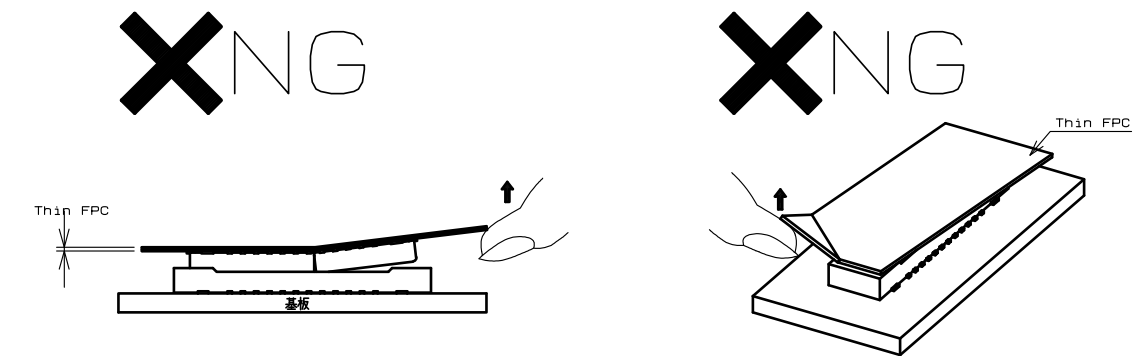
- (1) コネクタを取り外す際は、コネクタ搭載面に対して垂直報告に抜くのが望ましいですが、
基板対FPCでの取り外しの場合は、多極になればなるほど、また、FPCの厚みが薄いと、垂直方向に
取り外すのは困難になります。



- (2) 取り外しが困難な場合は、ピッチ方向側に斜めに取り外して下さい。
幅方向側からの取り外しは端子に大きな負担がかかりますので、ご注意下さい。
なお、幅方向から取り外す場合はFPCの端を垂直方向に引っ張り取り外して下さい。
(水平方向へ力が加わると端子に大きな負担が掛かります。)



- (3) FPCに十分な剛性がない場合は、はんだ剥離、コネクタ折れが発生する場合がありますので、
試作時など事前にご使用頂くFPCで繰り返し動作を確認の上、ご使用をお願い致します。
また、FPCのコーナー部を持って、斜めに取り外すと、端子に大きな負担が掛かりますので、
行わないで下さい。



HRS	DRAWING NO.	ADC-364666-51-00		
	PART NO.	BM28B0.6-24DS/2-0.35V<51>		
	CODE NO.	CL0673-5025-0-51	1	3/3